

戴尔 PowerEdge 机架式服务器

快速参考指南



戴尔 PowerEdge 机架式服务器可帮助您构建现代基础架构，从而更大限度减少 IT 难题并推动业务成功。我们的快速参考指南 (QRG) 包含整个机架式服务器产品组合的精简视图。

机架式服务器	R470	R570	R670	R770	R6715	R7715	R6725	R7725
								
重要属性	专为更最大限度地提高效率和经济性而设计，采用经过优化的单路服务器，能够为云级 Web 和应用程序微服务、数据服务、虚拟化以及横向扩展数据库提供强大的性能。	专为更最大限度地提高效率和经济性而设计，采用经过优化的单路服务器，能够为云级 Web 和应用程序微服务、数据服务、虚拟化以及横向扩展数据库提供强大的性能。	针对计算工作负载优化的开放式生态系统，旨在优化高密度部署、云原生应用程序和全闪存 SDS 的能效并平衡性能。	针对计算工作负载优化的开放式生态系统，可以为虚拟化和微服务、云原生应用程序以及大规模分析提供出色的性能和优化能效。	规模适当的内存和存储密度	更高的性能和价值	突破巅峰的性能密度	提供突破性的性能且可扩展
目标工作负载	虚拟化、横向扩展数据库、大数据和分析、高性能计算和边缘计算	中等密度虚拟化、横向扩展数据库、大数据和分析、VDI、高性能计算和软件定义的存储。	虚拟化、云原生应用程序、全闪存 SDS、超大规模工作负载和横向扩展数据库	虚拟化、人工智能推理、云原生应用程序、超大规模工作负载和横向扩展数据库	数据分析、密集虚拟化和软件定义的存储	数据分析、密集虚拟化和软件定义的存储	高性能计算 (HPC)、虚拟桌面基础架构 (VDI) 和虚拟化	高性能计算 (HPC)、虚拟桌面基础架构 (VDI) 和虚拟化
处理器类型	1 个英特尔®至强® 6 E-core 处理器或 1 个英特尔®至强® 6 P-core 处理器（最多 86 核，并且带 R1S 选项）	（最多 144 核）或 1 个英特尔®至强® 6 P-core 处理器（最多 86 核，并且带 R1S 选项）	2 个英特尔®至强® 6 E 核处理器，带多达 144 个核心，或者 2 个英特尔®至强® 6 P 核处理器，带多达 86 个核心		1 个 AMD EPYC™ 第 5 代 9005 系列处理器；每个处理器多达 160 个核心*		2 个 AMD EPYC™ 第 5 代 9005 系列处理器；每个处理器多达 192 个核心	
DDR5 DIMM 插槽（最大容量）	16 (4 TB*)	16 (4 TB*)	32 (8 TB)		24 (3 TB)	24 (6 TB)	24 (3 TB)	24 (6 TB)
磁盘驱动器多达：	4 个 3.5 英寸* 4 个 通用 8 个 2.5 英寸 10 个 2.5 英寸 8 个 E3.S / 16 个 E3.S* 4 个 E3.S（背面）*	8 个 2.5" 12 个 3.5 英寸 16 个 2.5 英寸 24 个 2.5 英寸* 8 个 E3.S / 16 个 E3.S / 32 个 E3.S* 4 个 E3.S（背面）	8 个 2.5 英寸 10 个 2.5** 8 个 E3.S / 16 个 E3.S / 20 个 E3.S* 2 个 E3.S（背面）*	8 个 2.5 英寸 16 个 2.5 英寸 24 个 2.5 英寸 8 个 E3.S/16 个 E3.S（FIO 配置） 32 个 E3.S / 40 个 E3.S* 4 个 E3.S（背面）*	4 个 3.5 英寸* 4 个 通用* 8 个 2.5 英寸 / U.2 10 个 2.5 英寸* 16 个 E3.S / 20 个 E3.S* 2 个 E3.S（背面）*	2 个 U.2 端口 8 个 2.5 英寸 / U.2* 12 个 3.5 英寸* 16 个 2.5 英寸 24 个 2.5 英寸* 8 个 E3.S / 16 个 E3.S / 32 个 E3.S* / 40 个 E3.S*	4 个 3.5 英寸* 4 个 U.2** 8 个 2.5 英寸 10 个 2.5** 8 个 E3.S / 16 个 E3.S / 20 个 E3.S* 2 个 E3.S（背面）*	8 个 2.5 英寸 / U.2 12 个 3.5 英寸* 16 个 2.5 英寸 24 个 2.5 英寸* 8 个 E3.S / 16 个 E3.S / 32 个 E3.S* / 40 个 E3.S*
NVMe 驱动器多达：	16*	32*	22*	44*	22*	40*	22*	40*
PCIe 5.0 插槽多达：	4*	4	3	8	3*	8*	3*	8*
PCIe 4.0 插槽多达：	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
加速器支持多达：	4 个 75 W SW*	3 个 400 W DW* 或 4 个 75 W SW	3 个 75 W SW*	2 个 350 W DW* 或 6 个 75 W SW*	3 个 75 W SW*	3 个 400 W DW* 或 6 个 75 W SW*	3 个 SW*	2 个 250/350/400 W DW* 或 6 个 75 W SW*
机架高度 (U)	1	2	1	2	1	2	1	2
集成的安全性	加密签名固件、静态数据加密（具有本地或外部密钥管理的 SED）、安全启动、安全组件验证（硬件完整性检查）、信任硅根、安全擦除、系统锁定（需要 iDRAC10 Enterprise 或 Datacenter）、TPM 2.0 FIPS、经过 CC-TCG 认证、机箱入侵检测				加密签名固件、静态数据加密（具有本地或外部密钥管理的 SED）、安全启动、安全组件验证（硬件完整性检查）、信任硅根、安全擦除、系统锁定、TPM 2.0 FIPS、经过 CC-TCG 认证、AMD 安全内存加密 (SME)、AMD 安全加密虚拟化 (SEV)、机箱入侵检测			

提醒：* 预计将在未来版本中提供。计划中的产品或服务可能会有所变动，并且可能不会按照最初的设计发布。

戴尔 PowerEdge 机架式服务器

快速参考指南



机架式服务器	R760	R660	R7625	R6625	R7615	R6615	R660xs	R760xs	HS5610***	HS5620***
										
重要属性	为要求苛刻的应用程序提供性能和多功能性	为要求苛刻的应用程序提供性能和多功能性	突破性的性能	突破性的性能	强大的性能和可扩展性	卓越的性能和出色的 TCO	针对常用 IT 应用程序确定适当的规模	针对常用 IT 应用程序确定适当的规模	针对计算工作负载优化的开放式生态系统	针对存储密集型工作负载优化的开放式生态系统
目标工作负载	混合工作负载标准化、数据库和分析、虚拟桌面基础架构	高密度虚拟化、高密度数据库分析、混合工作负载标准化	高性能计算 (HPC)、虚拟桌面基础架构 (VDI)、虚拟化	高性能计算 (HPC)、虚拟桌面基础架构 (VDI)、虚拟化	软件定义的存储 (SDS)、虚拟化、数据分析	虚拟化、超融合基础架构 (HCI)、网络功能虚拟化 (NFV)	虚拟化、云、横向扩展数据库、高性能计算 (HPC)	虚拟化、软件定义的存储、中等密度虚拟机或 VDI	虚拟化、横向扩展数据库、软件定义的存储节点	虚拟化、中等虚拟机密度或 VDI、软件定义的存储节点
处理器类型	2 个第 4 代英特尔® 至强® 可扩展处理器；每个处理器多达 56 个核心或 2 个第 5 代英特尔® 至强® 可扩展处理器；每个处理器多达 64 个核心		2 个 AMD EPYC™ 第 4 代 9004 系列处理器；每个处理器多达 128 个核心		1 个 AMD EPYC™ 第 4 代 9004 系列处理器；多达 128 个核心		2 个第 5 代英特尔® 至强® 可扩展处理器，带多达 28 个核心或 2 个第 4 代英特尔® 至强® 可扩展处理器；每个处理器多达 32 个核心		2 个第 5 代英特尔® 至强® 可扩展处理器，多达 32 个核心或 2 个第 4 代英特尔® 至强® 可扩展处理器；每个处理器多达 32 个核心	
DDR5 DIMM 插槽 (最大容量)	32 (8 TB)		24 (6 TB)		12 (3 TB)		16 (1.5 TB)		16 (2 TB)	
磁盘驱动器多达：	12 个 3.5" 8 个 2.5" 16 个 2.5" 24 个 2.5" 16 个 E3.S 2 个 2.5" (背面) 4 个 2.5" (背面) 4 个 E3.S (背面)	8 个 2.5" 10 个 2.5" 10 个 2.5" 14 个 E3.S 16 个 E3.S 2 个 2.5" (背面) 2 个 E3.S (背面)	8 个 3.5" 12 个 3.5" 8 个 2.5" 16 个 2.5" 24 个 2.5" 2 个 2.5" (背面) 4 个 2.5" (背面) 4 个 E3.S (背面)	4 个 3.5" 8 个 2.5" 10 个 2.5" 14 个 E3.S 16 个 E3.S 2 个 2.5" (背面) 2 个 E3.S (背面)	8 个 3.5" 12 个 3.5" 8 个 2.5" 16 个 2.5" 24 个 2.5" 2 个 2.5" (背面) 4 个 2.5" (背面) 4 个 E3.S (背面)	4 个 3.5" 8 个 2.5" 10 个 2.5" 14 个 E3.S 16 个 E3.S 2 个 2.5" (背面) 2 个 E3.S (背面)	4 个 3.5" 8 个 2.5" 10 个 2.5" 2 个 2.5" (背面)	12 个 3.5" 8 个 3.5" 8 个 2.5" 16 个 2.5" + 8 个 NVMe 2 个 2.5" (背面)	4 个 3.5" 8 个 2.5" 6 个 NVMe 10 个 2.5" 2 个 2.5" (背面)	12 个 3.5" 8 个 3.5" 8 个 2.5" 16 个 2.5" + 8 个 NVMe 2 个 2.5" (背面)
NVMe 驱动器多达：	24	10	24	10	24	10	10	8	10	8
PCIe 5.0 插槽多达：	4	2	4	2	4	2	2	2	2	2
PCIe 4.0 插槽多达：	8	3	8	3	4	3	3	4	3	4
加速器支持多达：	2 个 350 W DW 或 6 个 75 W SW	3 个 75 W SW	2 个 300 W DW 或 6 个 75 W SW	3 个 75 W SW	3 个 300 W DW 或 6 个 75 W SW	3 个 75 W SW	不适用	2 个 75 W SW	不适用	2 个 75 W SW
机架高度 (U)	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2
集成的安全性	TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 认证、TPM 2.0 中国 NationZ、加密签名固件、机箱防盗警报、标准安全启动、硅信任根、系统锁定（需要 iDRAC9 Enterprise 或数据中心）、静态数据加密（具有本地或外部密钥管理的 SED）、安全组件验证（硬件完整性检查）以及所有机架上的系统擦除。			TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 认证、TPM 2.0 中国 NationZ、加密签名固件、安全启动、安全擦除、硅信任根、系统锁定（需要 iDRAC9 Enterprise 或数据中心）、AMD 安全内存加密 (SME) 和 AMD 安全加密虚拟化 (SEV)			TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 认证、TPM 2.0 中国 NationZ、加密签名固件、机箱防盗警报、标准安全启动、硅信任根、系统锁定（需要 iDRAC9 Enterprise 或数据中心）、静态数据加密（具有本地或外部密钥管理的 SED）、安全组件验证（硬件完整性检查）以及所有机架上的系统擦除。			

提醒：* 预计将于 2025 年上半年推出。计划中的产品或服务可能会有所变动，并且可能不会按照最初的设计发布。

*** 通过 Hyperscale Next 计划为精选客户提供专属的 HS560 和 HS5620

戴尔 PowerEdge 机架式服务器

快速参考指南



机架式服务器	R960	R860	R760xa	R760xd2	R360	R260
						
重要属性	大幅提升业务连续性和横向扩展能力	利用高密度计算为业务关键型核心 workload 提供支持	适用于密集型 GPU 应用程序的高性能、可扩展的服务器	高密度存储、速度更快的检索和可扩展性	优化的工作效率、高端企业级 GPU 以及强大的计算能力，可满足常见业务应用程序的需求。	带过滤挡板的短深度机架式服务器，搭载最新的英特尔至强-E 2400 系列处理器、DDR5 内存、NVMe BOSS 和能源之星 4.0 PSU，专为近边缘客户设计
目标工作负载	大型内存中数据库、数据分析、AI 和虚拟化、虚拟桌面基础架构 (VDI)		AI/ML/DL 训练和推理 数字孪生、渲染图形 虚拟化和 VDI 图形	文件和对象存储、视频捕获和监控、视频流	协作和共享、邮件和消息传送、数据库	协作和共享、邮件和消息传送、近边缘应用程序
处理器类型	4 个第 4 代英特尔®至强®可扩展处理器，每个处理器多达 60 个核心，并可选配英特尔® QuickAssist 技术		2 个第 4 代英特尔® 至强® 可扩展处理器；每个处理器多达 56 个核心或 2 个第 5 代英特尔® 至强® 可扩展处理器；每个处理器多达 64 个核心	2 个第 4 代英特尔® 至强® 可扩展处理器；每处理器多达 32 个核心或 2 个第 5 代英特尔® 至强® 可扩展处理器；每个处理器多达 28 个核心	1 个英特尔®至强® E-2400 系列处理器，带多达 8 个核心或 1 个英特尔® 奔腾处理器，带 2 个核心或 1 个英特尔® 至强® 6300 系列处理器，带多达 8 个核心	1 个英特尔®至强® E-2400 系列处理器，带多达 8 个核心或 1 个英特尔® 奔腾处理器，带 2 个核心或 1 个英特尔® 至强® 6300 系列处理器，带多达 8 个核心
DDR5 DIMM 插槽 (最大容量)	64 (16 TB)		32 (8 TB)	16 (1.5 TB)	4 (128 GB)	4 (128 GB)
磁盘驱动器多达:	8 个 2.5" 16 个 2.5" 24 个 2.5" 32 个 2.5" 16 个 E3.S 8 个 2.5" + 16 个 E3.S	8 个 2.5" 16 个 2.5" 24 个 2.5" 8 个 E3.S 2 个 2.5" (背面)	6 个 2.5" 8 个 2.5" 6 个 E3.S	12 个 3.5" (前端托架) + 12 个 3.5" (中间托架) 2 个 2.5" 或 4 个 2.5" 或 4 个 3.5" 或 4 个 E3.S (背面)	4 个 3.5" 8 个 2.5"	2 个 3.5" 6 个 2.5"
NVMe 驱动器多达:	24	24	8	4	不适用	不适用
PCIe 5.0 插槽多达:	12	8	12	不适用	不适用	不适用
PCIe 4.0 插槽多达:	不适用	4	不适用	5	2	2
加速器支持多达:	4 个 400 W DW	不适用	4 个 400 W DW 或 12 个 75 W SW	2 个 75 W SW、1 个 75 W SW + 1 个 150 W SW 或 1 个 180 W DW	1 个 60 W SW	不适用
机架高度 (U)	4	2	2	2	1	1
集成的安全性	TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 认证、TPM 2.0 中国 NationZ、加密签名固件、机箱防盗警报、标准安全启动、硅信任根、系统锁定 (需要 iDRAC9 Enterprise 或数据中心)、静态数据加密 (具有本地或外部密钥管理的 SED)、安全组件验证 (硬件完整性检查) 以及所有机架上的系统擦除。					

戴尔 PowerEdge 机架式服务器

快速参考指南



机架式服务器	XE7745	XE7740	XE9680L	XE9685L
				
重要属性	内部 GPU 插槽专为 AI 推理、模型微调和高性能计算而打造，与八个用于网络连接的额外 Gen 5.0 PCIe 插槽配对，可实现密集、灵活的配置，其 DW PCIe GPU 容量是 Dell PowerEdge R760xa 的两倍	内部 GPU 插槽专为 AI 推理、模型微调和高性能计算而打造，与八个用于网络连接的额外 Gen 5.0 PCIe 插槽配对，可实现密集、灵活的配置，其 DW PCIe GPU 容量是 Dell PowerEdge R760xa 的两倍	采用 4U 外形规格设计，利用直接液冷技术对 CPU 和 GPU 进行散热，可实现卓越的 AI 训练和 HPC 性能	采用 4U 外形规格设计，利用直接液冷技术对 CPU 和 GPU 进行散热，可实现卓越的 AI 训练和 HPC 性能
目标工作负载	生成式 AI 微调、生成式 AI 推理、自然语言处理、数字孪生和代理 AI	生成式 AI 微调、生成式 AI 推理、自然语言处理、数字孪生和代理 AI	AI 训练、LLM 训练、微调和大规模 LLM 推理	AI 训练、LLM 训练、微调和大规模 LLM 推理
处理器类型	两个第 5 代 AMD EPYC™ 9005 系列处理器，每个处理器具有多达 192 个核心	2 个第 5 代英特尔® 至强® 可扩展处理器；每个处理器多达 56 个核心	两个第 5 代英特尔® 至强® 可扩展处理器；每个处理器多达 64 个核心	两个第 5 代 AMD EPYC™ 9005 系列处理器，每个处理器具有多达 192 个核心
DDR5 DIMM 插槽（最大容量）	24 (3 TB)	24 (3 TB)	32 (4 TB)	24 (3 TB)
磁盘驱动器多达：	8 个 E3.S	8 个 E3.S	8 个 2.5"	8 个 2.5"
NVMe 驱动器多达：	不适用	不适用	8	8
PCIe 5.0 插槽多达：	8	8	12	12
PCIe 4.0 插槽多达：	不适用	不适用	不适用	不适用
加速器支持多达：	8 个 600 W SW 或 16 个 75 W SW	8 个 600 W SW 或 16 个 75 W SW	8 个 NVIDIA HGX B200 180GB 1000W SXM6 GPU，与 NVIDIA NVLink 技术完全互连	8 个 NVIDIA HGX B200 180GB 1000W SXM6 GPU，与 NVIDIA NVLink 技术完全互连
机架高度 (U)	4	4	4	4
集成机架	不适用	不适用	需要 IR5000	需要 IR5000
集成的安全性	加密签名固件、静态数据加密（具有本地或外部密钥管理的 SED）、安全启动、安全组件验证（硬件完整性检查）、信任硅根、安全擦除、系统锁定（需要 iDRAC10 Enterprise 或 Datacenter）*、TPM 2.0 FIPS、经过 CC-TCG 认证、AMD 安全内存加密 (SME)、AMD 安全加密虚拟化 (SEV)	机箱入侵检测、加密签名固件、静态数据加密（具有本地或外部密钥管理的 SED）*、安全启动、安全组件验证（硬件完整性检查）、安全擦除、信任硅根、系统锁定（需要 iDRAC10 Enterprise 或 Datacenter）、TPM 2.0 FIPS、经过 CC-TCG 认证	加密签名固件、静态数据加密（具有本地或外部密钥管理的 SED）、安全启动、安全组件验证（硬件完整性检查）、安全擦除、信任硅根、系统锁定（需要 iDRAC9 Enterprise 或 Datacenter）、TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 认证	加密签名固件、静态数据加密（具有本地或外部密钥管理的 SED）、安全启动、安全组件验证（硬件完整性检查）、安全擦除、信任硅根、系统锁定（需要 iDRAC9 Enterprise 或 Datacenter）、TPM 2.0 FIPS、经过 CC-TCG 认证

提醒：*预计将于 2025 年上半年推出。计划中的产品或服务可能会有所变动，并且可能不会按照最初的设计发布。

戴尔 PowerEdge 机架式服务器

快速参考指南



机架式服务器	XE9680	XE9640	XE8640	XR7620	XR5610
					
重要属性	不折不扣的 AI 训练性能加速，支持灵活选择 H100 GPU，6U 双路，最高支持 35°C 的环境温度	采用 2U 外形规格设计，利用直接液冷技术对 CPU 和 GPU 进行散热，密度经过全面优化，可实现卓越的 AI 和 HPC 性能	更快的 ML/DL 训练和 HPC 性能，4U 双路服务器，最高支持 35°C 的环境温度，标准机架深度	针对边缘优化的高性能、高容量短深度 2U 双路服务器	高性能，短深度，加固型，反向安装，带过滤挡板，工作温度为 -5°C 至 55°C
目标工作负载	大型模型训练、自然语言处理、推荐引擎、对话式 AI、翻译、药物研发	HPC 建模和模拟、地震分析、计算流体力学、石油和天然气，AI/ML 训练、对象检测、图像分类	HPC 建模和模拟、地震分析、计算流体力学、石油和天然气，AI/ML 训练、对象检测、图像分类	工业自动化、视频分析、销售点分析、AI 推理、边缘资产数据聚合和分析	vRAN、D-RAN、O-RAN、工业自动化、视频分析、销售点分析、AI 推理、边缘资产数据聚合和分析
处理器类型	2 个第 4 代英特尔®至强®可扩展处理器，每个处理器多达 56 个核心或 2 个第 5 代英特尔®至强®可扩展处理器每个处理器多达 56 个核心	2 个第 4 代英特尔®至强®可扩展处理器；每个处理器多达 56 个核心或 2 个第 5 代英特尔®至强®可扩展处理器；每个处理器多达 64 个核心	2 个第 4 代英特尔®至强®可扩展处理器；每个处理器多达 56 个核心或 2 个第 5 代英特尔®至强®可扩展处理器；每个处理器多达 64 个核心	两个第 5 代英特尔®至强®可扩展处理器；每个处理器多达 16 个核心或 2 个第 4 代英特尔®至强®可扩展处理器；每个处理器多达 32 个核心	1 个第 5 代英特尔®至强®可扩展处理器，每个处理器多达 16 个核心或 1 个第 4 代英特尔®至强®可扩展处理器每个处理器多达 32 个核心
DDR5 DIMM 插槽 (最大容量)	32 (4 TB)	• 16 (1 TB) 英特尔 GPU • 8、16、32 (2 TB) NVIDIA GPU	32 (4 TB)	16 (1 TB)	8 (1 TB)
磁盘驱动器多达：	8 个 2.5" 16 个 E3.S	4 个 2.5"	8 个 2.5"	4 个 2.5" 8 个 E3.S	4 个 2.5"
NVMe 驱动器多达：	8	4	8	4	4
PCIe 5.0 插槽多达：	10	4	4	2	2
PCIe 4.0 插槽多达：	不适用	不适用	不适用	5	不适用
加速器支持多达：	8 个 NVIDIA HGX H100 80 GB 700 W SXM5 GPU 或 NVIDIA HGX H800 8 GPU SXM 80GB 700W GPU、NVIDIA HGX H200 8 GPU SXM 141GB 700W GPU、NVIDIA HGX H20 8 GPU SXM 96GB 500W GPU 或 8 个 AMD Instinct MI300X 192GB 750W OAM GPU 或 8 个英特尔 Gaudi3 128GB 900W OAM GPU	4 个 NVIDIA H100 SXM 7000W NVLINK GPU 或英特尔 Data Center Max GPU Series 1550 OAM 600W Xelink GPU	4 个 NVIDIA HGX H100 80 GB 700 W SXM5 GPU，与 NVIDIA NVLink 技术完全互连	4 个 150 W SW 或 2 个 300 W DW	2 个 75 W SW
机架高度 (U)	6	2	4	2	1
集成机架	可选：IR5000	不适用	不适用	不适用	不适用
集成的安全性	TPM 2.0 FIPS、CC-TCG 认证、TPM 2.0 中国 NationZ、加密签名固件、机箱防盗警报、标准安全启动、硅信任根、系统锁定（需要 iDRAC9 Enterprise 或数据中心）、静态数据加密（具有本地或外部密钥管理的 SED）、安全组件验证（硬件完整性检查）以及所有机架上的系统擦除。				

提醒：*预计将于 2025 年上半年推出。计划中的产品或服务可能会有所变动，并且可能不会按照最初的设计发布。

戴尔 PowerEdge 机架式服务器

快速参考指南



机架式服务器	R750	R750xa	R650	R7525	R6525	R7515	R6515	R750xs	R650xs	R450	R550	XR11	XR12	R350	R250
															
重要属性	为要求较高的工作负载提供出色的性能	高度密集的 GPU 工作负载	高可扩展性、优化的工作负载性能	强大的性能和灵活性	密集虚拟化	强大的性能和可扩展性	高密度计算	专门构建的 2U 服务器，打造不断发展的横向扩展解决方案	专门构建的全性能 1U 服务器，打造密集、快速发展的横向扩展解决方案	超值和高密度，专为一般用途 IT 而构建	通用、价值优化、虚拟化就绪，专为一般用途 IT 而构建	以边缘为中心、较深、耐用，提供反向装载选项	以边缘为中心、较深、耐用，提供反向装载选项	在 1U 服务器中提供强大的性能，适用于生产力和数据密集型应用程序	强大的计算能力，适用于常见业务应用程序并提高工作效率
目标工作负载	数据库和分析、HPC、传统公司 IT、VDI、AI 或 ML 环境	AI、ML 或 DL 培训或推论、HPC 和虚拟化环境	混合工作负载标准化、数据库和分析、HFT、传统企业 IT、VDI、HPC、AI 或 ML 环境	全闪存 SDS、VDI 和数据分析	HPC、密集型 VDI 和虚拟化	SDS、虚拟化和数据分析	虚拟化、HCI 和 NFV	虚拟化、中型虚拟机密度或 VDI 和横向扩展数据库工作负载	虚拟化、云、横向扩展数据库和高性能计算工作负载	小型 IT 基础架构、轻型虚拟机、小型企业特定工作负载	小型 IT 基础架构、轻型虚拟机密度、小型企业特定工作负载	电讯/5G（MEC、CDN、vRAN）、军事、零售（分析 - 视频监控/ POS/IOT 聚合）	电讯/5G（MEC、CDN、vRAN）、军事、零售（分析 - 视频监控/ POS/IOT 聚合）	中小型企业、远程办公室/分支机构、协作和共享、数据分析和虚拟化工作负载	中小型企业、远程办公室/分支机构、协作和共享、邮件/消息传送以及文件/打印工作负载
处理器类型	2 个第 3 代英特尔® 至强® 可扩展处理器；每个处理器多达 40 个核心			2 个第 2 代或第 3 代 AMD EPYC™ 处理器；每个处理器多达 64 个核心		1 个第 2 代或第 3 代 AMD EPYC™ 处理器；每个处理器多达 64 个核心		2 个第 3 代英特尔® 至强® 可扩展处理器；每个处理器多达 32 个核心		2 个第 3 代英特尔® 至强® 可扩展处理器；每个处理器多达 24 个核心		1 个第 3 代英特尔® 至强® 可扩展处理器；每个处理器多达 36 个核心		1 个英特尔至强 E-2300 系列处理器，配备多达 8 个核心，或 1 个英特尔奔腾处理器，配备多达 2 个核心	
DDR4 DIMM 插槽（最大容量）	32 (8 TB)		32 (4 TB)			16 (2 TB)		16 (1 TB)			8 (1 TB)		4 (128 GB)		
磁盘驱动器多达：	12 个 3.5" 8 个 2.5" 16 个 2.5" 24 个 2.5" 2 x 2.5" 或 4 个 2.5"（背面）	6 个 2.5" 8 个 2.5"	4 个 3.5" 8 个 2.5" 10 个 2.5" 2 个 2.5"（背面）	12 个 3.5" 26 个 2.5"	4 个 3.5" 12 个 2.5"	12 个 3.5" 24 个 2.5"	4 个 3.5" 8 个 2.5"	8 个 3.5" 12 个 3.5" 8 个 2.5" 16 个 2.5" + 8 个 2.5"	4 个 3.5" 8 个 2.5" 10 个 2.5" 2 个 2.5"（背面）	4 个 3.5" 8 个 2.5"	8 个 3.5" 8 个 2.5" 16 个 2.5"	4 个 2.5"	6 个 2.5"	4 个 3.5" 8 个 2.5"	4 个 3.5" 4 个 3.5"（有线） 2 个 3.5"（有线）
NVMe 驱动器多达：	24	8	12	24	12	24	10	8	10	不适用		4	6	不适用	
PCIe 4.0 插槽多达：	8	8	3	8	3	2	1	5	3	2	3	3	5	3	2
PCIe 3.0 插槽多达：	不适用					2	1	1	不适用		1	不适用			
加速器支持多达：	2 个 300 W DW 或 4 个 150 W SW 或 6 个 75 W SW	4 个 150 W SW 或 4 个 300 W DW 2 个 75 W SW	3 个 75 W SW	3 个 300 W DW 或 6 个 75 W SW	3 个 SW	4 个 SW； 1 个 DW； 1 个 FPGA	1 个 SW	不适用				2 个 75 W SW	2 个 75 W 或 150 W SW 2 个 300 W DW	不适用	
机架高度 (U)	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	1
集成的安全性	TPM 1.2/2.0 FIPS、CC-TCG 认证、TPM 2.0 中国 NationZ、加密签名固件、机箱防盗警报，以及在所有机架上的标准安全启动。集成的安全性功能，例如硅根信任、系统锁定（需要 iDRAC9 Enterprise 或 Datacenter）以及所有机架上的系统擦除														

机架式服务器	R940	R940xa	R840	R740xd	R740	R740xd2	R640	R540	R440	R340	R240
											
重要属性	强大的性能	大幅提速	大幅提升数据分析能力	可扩展的存储性能	优化应用程序性能	企业内容服务器	性能和密度	平衡和适应性	横向扩展计算	加速业务增长	轻松计算
目标工作负载	内存中数据库	GPU 数据库加速和机器学习	数据密集型工作负载、HFT 和密集虚拟化	SDS、服务提供商和大数据服务器	VDI 和云工作负载	媒体流和 SDS	密集的横向扩展数据中心计算和存储	邮件消息传送和虚拟化	HPC、web 技术人员和横向扩展基础架构	ROBO 工作效率和数据密集型应用程序	小型企业和服务提供商工作负载
处理器类型	4 个第 2 代英特尔® 至强® 可扩展处理器			2 个第 2 代英特尔® 至强® 可扩展处理器				1 个 英特尔至强 E-2200、英特尔酷睿 i3®、英特尔奔腾® 或英特尔赛扬® 处理器			
DDR4 DIMM 插槽 (最大容量)	48 (15.36 TB)			24 (7.68 TB)		16 (1 TB)	24 (7.68 TB)	16 (1 TB)		4 (64 GB)	
磁盘驱动器多达:	24 个 2.5"	32 个 2.5"	26 个 2.5"	18 个 3.5" 32 个 2.5"	8 个 3.5" 16 个 2.5"	26 个 3.5" 16 个 3.5" 10 个 2.5" ²	4 个 3.5" 12 个 2.5"	14 个 3.5"	4 个 3.5" 10 个 2.5"	4 个 3.5" 8 个 2.5"	4 个 3.5" 4 个 2.5" ²
NVMe 驱动器多达:	12	4	24	不适用			10	不适用	4	不适用	
PCIe 4.0 插槽多达:	不适用										
PCIe 3.0 插槽多达:	13	12	6	8	5	3	5	2	2		
加速器支持多达:	不适用	4 个 DW GPU 或 4 个 DW 或 8 个 SW FPGA	2 个 DW GPU 或 2 个 SW 或 DW FPGA	3 个 DW 或 6 个 SW GPU 或 3 个 DW 或 4 个 SW FPGA	不适用		1 个 SW GPU 或 1 个 SW FPGA	不适用			
机架高度 (U)	3	4	2				1	2	1	1	
集成的安全性	TPM 1.2/2.0 FIPS、CC-TCG 认证、TPM 2.0 中国 NationZ、加密签名固件、机箱防盗警报，以及在所有机架上的标准安全启动。集成的安全性功能，例如硅根信任、系统锁定（需要 iDRAC9 Enterprise 或 Datacenter）以及所有机架上的系统擦除										

¹ 并非所有功能在所有平台上都可用。

² 驱动器使用混合托盘装入 3.5" 驱动器托架。（适用于 R740xd2 — 混合配置可提供多达 10 个 2.5" SSD）

用于零信任 IT 环境和运营的网络弹性体系结构

安全性集成在 PowerEdge 生命周期的每个阶段，包括受保护的供应链和工厂到站点完整性保障。基于芯片的信任根内置端到端启动弹性，而多重身份验证 (MFA) 和基于角色的访问控制可保护可信操作。

可持续发展

从我们产品和包装中的回收材料，到高能效的深思熟虑的创新选项，PowerEdge 产品组合旨在制造、交付和回收产品，以帮助减少碳排放量并降低运营成本。携手 Dell Technologies，甚至可以轻松负责任地淘汰旧式系统。

通过自动基础架构提高效率并加速运营

Dell OpenManage Systems Management 产品组合可以降低管理和保护 IT 基础架构的复杂性。使用 Dell Technologies 的直观端到端工具，IT 可以通过减少流程和信息库来提供安全的集成式体验，从而专注于业务发展。Dell OpenManage 产品组合是创新引擎的关键，可以充分发挥工具和自动化作用，帮助您扩展、管理和保护您的技术环境。

借助 Dell Technologies Services，让您高枕无忧

我们全面的服务，随时随地助您充分发挥 PowerEdge 服务器的效能。借助 [Professional Services for AI](#) 在高 AI 应用场景中缩短实现价值的时间，通过 [ProDeploy Suite](#) 从量身定制的部署选项中进行选择，通过我们的 [ProSupport Suite](#) 获得主动式和预测式支持。我们遍布 170 个国家/地区的网点和 6 万多名员工及合作伙伴还将为您提供更多服务。

查找有关 PowerEdge 服务器的更多信息



[详细了解](#) 适用于 PowerEdge 服务器的服务



[详细了解](#) 系统管理解决方案



[搜索](#) 资源库



[关注](#) X (以前称为 Twitter) 上的 PowerEdge 服务器



联系 Dell Technologies 专家了解 [销售或支持](#)



[关注](#) LinkedIn 上的 PowerEdge 服务器